

中信建投证券股份有限公司
关于深圳市明微电子股份有限公司
部分募投项目结项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“明微电子”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对明微电子首次公开发行股票募投项目“集成电路封装项目”结项事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2871号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股1,859.20万股，每股发行价格为每股人民币38.43元，募集资金总额为人民币71,449.06万元，扣除发行费用人民币7,212.26万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币64,236.79万元。上述募集资金已经全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2020年12月14日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]518Z0053号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳市明微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目	18,994	18,994

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
2	集成电路封装项目	13,827	13,827
3	研发创新中心建设项目	8,408	8,408
4	补充流动资金	5,000	5,000
合 计		46,229	46,229

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“集成电路封装项目”。截至2022年6月26日，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投资总额	累计投入募集资金金额	尚未使用募集资金金额	募集资金节余金额	项目进展情况
集成电路封装项目	13,827.00	13,837.34	0.00	0.04	已结项
合计	13,827.00	13,837.34	0.00	0.04	-

注：累计投入募集资金金额与募集资金拟投资总额差额为10.34万元，募集资金节余金额0.04万元，均来源于募集资金的利息收入。

本次结项募投项目募集资金节余的主要原因为募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。

四、节余募集资金使用计划

“集成电路封装项目”已基本投资完成，设备已达到可使用状态。结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将该项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

公司全资子公司山东贞明半导体技术有限公司将于近期办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司及项目实施主体与开户银行、保荐机构签署的募集资金专户存储三方监管协议随之终止。

五、相关审议程序及意见

2022年6月27日，公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司将“集成电路封装项目”结项。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次将“集成电路封装项目”结项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。我们同意公司首次公开发行股票部分募投项目结项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目“集成电路封装项目”结项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司首次公开发行股票部分募投项目结项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司首次公开发行股票募投项目“集成电路封装项目”结项事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，符合全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目“集成电路封装项目”结项事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市明微电子股份有限公司部分募投项目结项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

龙敏

余皓亮

龙敏

余皓亮

中信建投证券股份有限公司



2022年6月5日